

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18沪建Y3

公告编号：临2023-032

上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）下属子公司上海建工四建集团有限公司（简称“四建集团”）与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（简称“十一科技”）组成联合体，参与了华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目工程总承包（简称“本项目”）竞标。经评标，本联合体为本项目中标人，并收到了《中标通知书》，现将中标情况公告如下：

一、本项目基本情况

本项目中标价 82.80 亿元。项目位于无锡市新吴区新洲路 30-1 号，总建筑面积 529,190 平方米，包括但不限于项目的深化设计（含二次深化设计）、施工图设计、设备采购、安装施工、承包人协助发包人与政府相关职能部门协调、用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作的全过程服务及相应的质保保修服务，承包人承担本项目的工程总承包（EPC）责任。本项目计划工期 716 天。

根据投标阶段《联合体协议书》约定，十一科技为本项目牵头单位，四建集团主要负责合同范围内的土建（包括室外）施工、验收、交付及维保等（经初步估算，约占联合体总中标金额的 40%）。

二、本项目对公司的影响

本项目中标体现了公司在集成电路等先进制造业工程领域的竞争优势及重大工程建设能力，项目的顺利实施有望对公司的未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

后续，联合体将依照招投标条件与招标方签订工程总承包合同。工程结算金额将依照实际签订的工程总承包合同及审价结果为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年5月18日